

KCケーシーボンド II_{SA}(温暖期用)成分表

	成 分	割 合 (%)
主 剤	ビスフェノール A エポキシ樹脂	30~40
	ベンジルアルコール	1~10
	シリカ	1~10
	二酸化チタン(ナノ粒子以外)	1未満
	無機充填剤	60~70

	成 分	割 合 (%)
硬 化 剤	ポリチオール	1~10
	ポリアミドアミン	10~20
	2-エチルヘキサン酸	1未満
	シリカ	30~40
	無機充填剤	20~30